下载日志已记录，仅供内部参考

康宁发布 Glass Bridge，CPO 进程再提速

2026 年 06 月 27 日

核心观点

- **一周主要指数周线回调，科技板块表现弱于市场：**一周（2026.06.22-2026.06.28）主要指数中，S&P500 涨跌幅为-1.95%，纳指涨跌幅为-4.60%，道指涨跌幅为-1.85%；科技行业方面，以科技成长股为主的 Nasdaq-100 指数涨跌幅为-4.24%，费城半导体指数涨跌幅为-7.94%。科技市场整体指数方面，Nasdaq-100 及费城半导体指数均录得周线下跌，且表现弱于市场。子行业方面，Nasdaq-100 中，周涨幅靠前的标的主要集中于光通信/光纤光缆、设备厂商及行业应用等板块；周跌幅靠前的公司主要集中于云服务、卫星通信及算力服务（AIDC）等板块。

- **核心观点：**康宁推出下一代玻璃基板光互连技术，旨在连接光半导体和光纤，面向新兴的共封光学（CPO）和玻璃芯半导体封装架构。公司于 6 月 24 日在首尔浦项大厦（POSCO Tower Yeoksam）举办的 AI 数据中心光通信与互联技术大会上，首次亮相了 Glass Bridge 光互连组件。

  我们认为，此次 Glass Bridge 的发布是光进铜退进程中的重要节点，其产业意义可从三个层面理解。1）技术层面，CPO（共封光学）规模化落地的核心瓶颈之一，正是光子芯片与光纤间因模场尺寸差异（数百纳米 vs.数微米）带来的高耦合损耗与精密对准难题，传统 FAU 方案通道间距大、密度受限且封装后难维护；Glass Bridge 借助玻璃内部离子交换波导做模场过渡，支持 30 μm 级高密度通道（较 127μm FAU 密度提升约 4 倍）、耦合损耗<2dB 且可实现 TMT 插芯可拆卸被动对准，实质上把 CPO 从实验室可通光推向机房可运维。**2）材料层面，**玻璃基板凭借透光性（适配光波导）、热膨胀系数与硅匹配、TGV（玻璃通孔）成本优于硅 TSV 等特性，正在从显示/盖板传统领地切入高端半导体封装与光互连核心环节，与有机基板（高频损耗大）、硅中介层（不透光、贵）形成差异化卡位，康宁将显示玻璃/玻纤积累平移至 AI 基建，是材料端护城河被重估的典型样本。**3）产业趋势层面，**AI Factory 的瓶颈正从单卡算力向外溢至机架内/集群间光互连的带宽、功耗与密度，可插拔光模块→LPO→CPO 的技术代际切换已开启，玻璃基光波导、TGV 工艺、可拆卸光连接、CPO 封装等环节的价值量占比将持续抬升；康宁同期推出 GlassWorks AI 全栈平台（芯片/板/机架/园区级）及玻璃基 CPO 基板方案，并与格芯联合验证、在美/波扩产、拿下 Meta/NVIDIA/亚马逊数十亿美元级长协，表明头部云厂与算力玩家已在供给侧锁定玻璃基光互连产能。对产业链而言，Glass Bridge 的产业化提速将进一步把订单与估值弹性向玻璃基板材料、TGV 加工、IOX/硅光波导、CPO 封装与可拆卸光连接等细分环节扩散。

- **投资建议：**建议关注相关龙头标的：光模块/光通信相关标的：Lumentum（LITE）,Coherent（COHR），Fabrinet（FN），Corning Inc.（GLW），Applied Optoelectronics（AAOI）等；设备制造相关标的：Ciena（CIEN），Cisco Systems（CSCO），Micron Technology（MU）等；运营商相关标的：AT&T（T），Verizon（VZ），T-Mobile US（TMUS）等；行业相关标的：Oracle（ORCL），Nvidia（NVDA）等。

海外算力行业

推荐 维持评级

分析师

赵良毕

☎：010-8092-7619

✉：zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522030003

相对标普 500 表现图

2026 年 06 月 26 日



资料来源：中国银河证券研究院

风险提示

1、AIGC 应用推广不及预期的风险；

2、下游 CSP 厂商 Capex 不及预期的风险；

3、政策和技术摩擦的不确定性风险；

4、5G 规模化商用推进不及预期的风险等

相关研究

1.【银河海外算力】行业深度_磷化铟供需缺口下的光器件产业变局和投资机遇

2.【银河海外算力】行业周报_谷歌采购算力容量，MRVL 纳入 S&P500

3.【银河海外算力】行业周报_Intel 加码玻璃基板，Dell 财报超预期

下载日志已记录，仅供内部参考

目录
Catalog

一、 本周行情回顾 3
（一） 海外主要指数回顾 3
（二） 各子行业表现情况 4
（三） 一周行业龙头标的表现 4
二、 周主要事件梳理 5
（一） 设备制造 5
（二） 卫星通信 6
（三） AI 应用 7
（四） 光通信 7
三、 行业数据跟踪 8
（一） 大模型 Tokens 调用量 8
（二） 热门 GPU 价格走势 9
（三） 子行业技术趋势 10
四、 投资建议 11
五、 风险提示 11

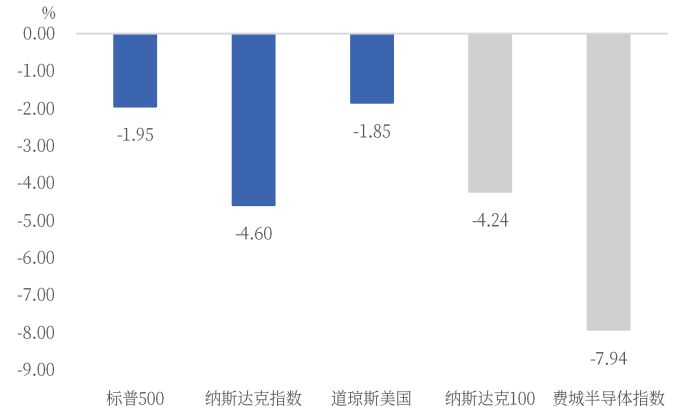
下载日志已记录，仅供内部参考

一、本周行情回顾

（一）海外主要指数回顾

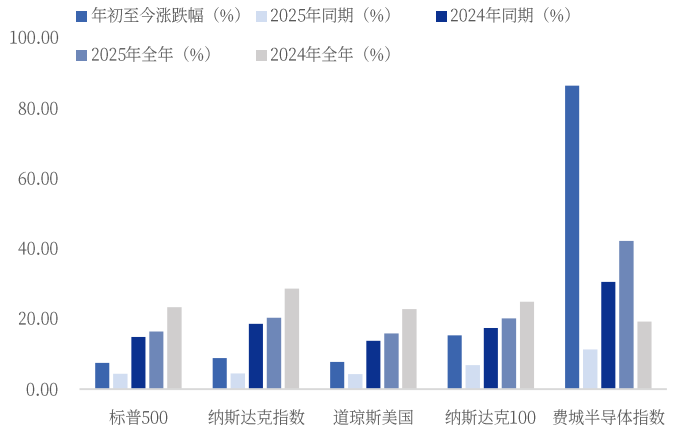
一周主要指数周线回调，科技板块表现弱于市场： 一周（2026.06.22-2026.06.28）主要指数中，S&P500 涨跌幅为 -1.95%，纳指涨跌幅为 -4.60%，道指涨跌幅为 -1.85%；科技行业方面，以科技成长股为主的 Nasdaq-100 指数涨跌幅为 -4.24%，费城半导体指数涨跌幅为 -7.94%。年初至今涨跌幅方面，费城半导体指数仍维持较高涨幅，表明板块中长期交易热度仍在，阶段性波动有所放大。

图1：各主要指数一周涨跌幅对比



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

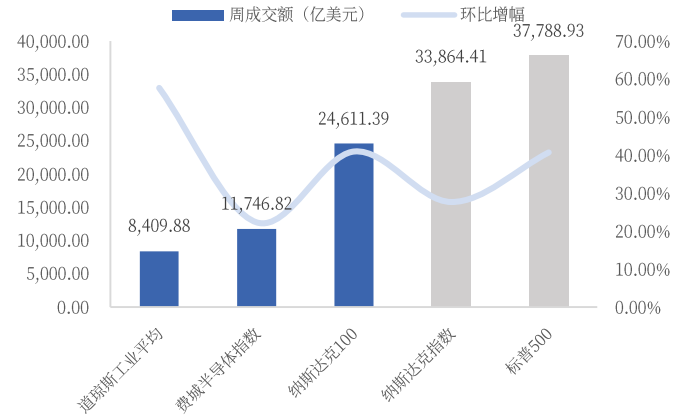
图2：各主要指数年初至今涨跌幅对比



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

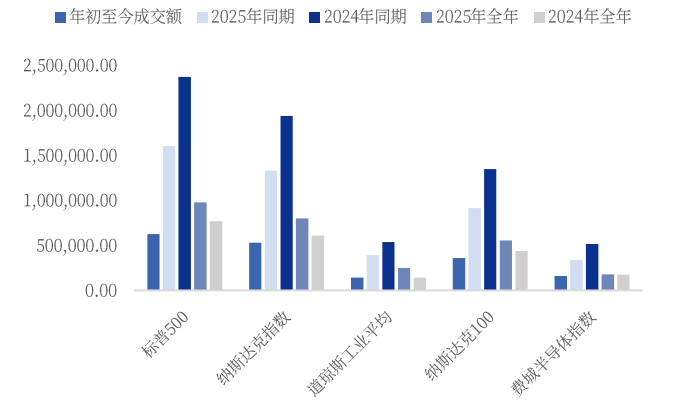
成交额方面， 上周主要指数成交额整体维持高位，标普 500、纳指及 Nasdaq-100 周成交额分别为 37,788.93 亿美元、33,864.41 亿美元、24,611.39 亿美元；环比来看，主要指数成交额均有所提升，其中道指、标普 500 及 Nasdaq-100 增幅相对较大。相比 2025 年及 2024 年同期，当前年度成交额整体仍处于较高水平，表明市场交投活跃度维持高位。

图3：各主要指数一周成交额对比



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图4：各主要指数年初至今成交额对比（亿美元）



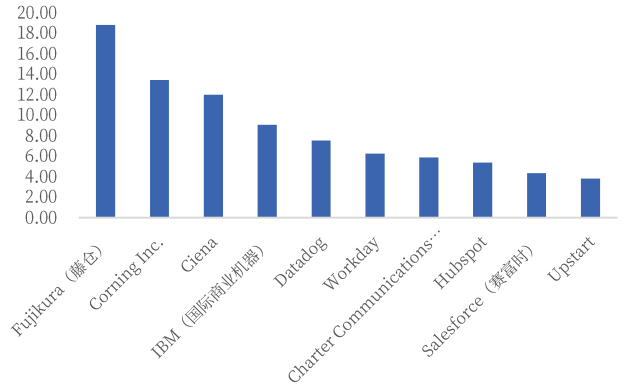
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

下载日志已记录，仅供内部参考

（二）各子行业表现情况

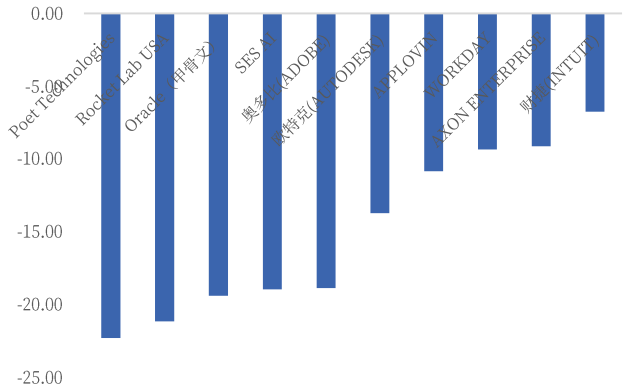
子行业方面，Nasdaq-100 中，周涨幅靠前的标的主要集中于光通信/光纤光缆、设备厂商及行业应用等板块；周跌幅靠前的公司主要集中于云服务、卫星通信及算力服务（AIDC）等板块。

图5：Nasdaq-100 中周涨幅前十名标的汇总（%）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图6：Nasdaq-100 中周跌幅前十名标的汇总（%）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

（三）一周行业龙头标的表现

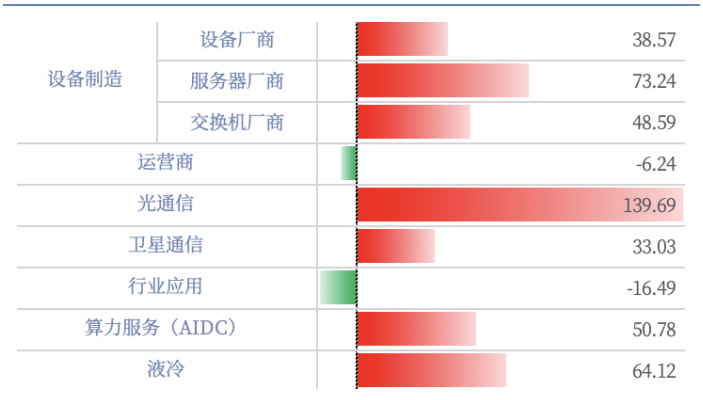
根据我们对于海外算力行业划分子板块，海外算力板块子行业包括设备制造（设备厂商、服务器厂商、交换机厂商）、运营商、光通信、卫星通信、行业应用、算力服务（AIDC）、液冷七大板块，一周内板块表现整体承压，仅运营商板块小幅上涨，板块涨幅为 0.94%；跌幅前三的板块分别为卫星通信、算力服务（AIDC）、光通信，板块跌幅分别为 8.62%、8.38%、6.41%。

图7：一周细分子板块涨跌幅情况（%）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图8：年初至今子板块涨跌幅（%）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

上述行业分类包含的公司中，一周涨幅前五的行业龙头标的，按照涨幅降序分别为 Fujikura（藤仓）、Corning Inc.、Ciena、IBM（国际商业机器）、Datadog，涨幅分别为 18.79%、13.41%、11.98%、9.04%、7.52%。

回调标的按照跌幅降序分别为 Poet Technologies、Rocket Lab USA、Oracle（甲骨文）、SES AI、Coreweave，跌幅分别为 22.30%、21.17%、19.40%、18.96%、18.12%。

下载日志已记录，仅供内部参考

二、周主要事件梳理

（一）设备制造

■ Dell Technologies（DELL.N）：扩展 Dell AI Factory 方案，推出 AI 服务器与机架级基础设施新品

Dell Technologies 发布多项 AI 基础设施更新，扩展 Dell AI Factory with NVIDIA 产品组合，覆盖服务器、存储、网络和数据管理等环节。公司推出 Dell PowerEdge XE9780、PowerEdge XE9785 等 AI 服务器，并预告面向 NVIDIA 下一代平台的机架级方案，用于支持企业 AI 训练、推理和高性能计算部署。

产品配置方面，Dell 新服务器将支持 NVIDIA HGX B300、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 等加速器，并配套 Dell PowerSwitch 网络、Dell PowerScale 存储及相关数据管理软件。Dell 表示，相关系统面向大规模 AI 工作负载设计，可用于模型训练、推理、检索增强生成、智能体 AI 等企业级场景。

此外，Dell 还介绍了与 NVIDIA 合作的 Dell PowerRack 机架级 AI 基础设施路线，计划支持未来 NVIDIA Vera Rubin 平台。公司称，PowerRack 将采用液冷设计，并通过机架级集成方式提供计算、网络和散热能力，面向更高密度 AI 集群部署需求。

■ HPE（HPE.N）：推出超算软件与系统更新，简化主权 AI 和科研计算部署

HPE 称，公司正在扩展超算产品组合，面向主权 AI、科研机构和大型企业简化超算系统的部署、管理和运营。相关更新包括 HPE Supercomputing Programming Software、HPE ProLiant Compute 平台支持，以及面向网络、存储和系统生命周期管理的多项功能。

软件方面，HPE Supercomputing Programming Software 将支持开发者在多供应商环境中编译、调试和优化 AI 与 HPC 应用，并可用于 HPE Cray Supercomputing EX 和 HPE ProLiant Compute 系统。HPE 还推出 HPE Slingshot 400 相关软件能力，支持多租户、高性能网络连接，服务共享超算资源中的 AI 和科研工作负载。

存储和服务方面，HPE 介绍了 HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 的新管理界面和 API，用于简化高性能存储系统部署与监控。公司还提到，HPE Financial Services 可为客户提供设备回收、数据擦除和资产生命周期管理服务；2025 年其处理的服务器中约 85% 被升级再利用，已安全擦除超过 1.7EB 数据。

■ IBM（IBM.N）/ OpenAI：合作将前沿 AI 引入网络安全防御场景

IBM 宣布与 OpenAI 合作，将 OpenAI 前沿模型接入 IBM 网络安全产品，用于帮助企业应对机器速度下的网络威胁。双方将首先把相关能力引入 IBM QRadar Suite，覆盖威胁检测、调查、响应和安全运营等环节。

产品能力方面，IBM 计划将 OpenAI 模型与自身安全 AI、自动化和威胁情报能力结合，支持安全团队更快分析告警、识别攻击路径、生成调查摘要，并辅助完成响应流程。IBM 表示，相关能力将帮助安全分析师处理更大规模的安全数据和事件，提高安全运营中心的工作效率。

IBM 还表示，双方合作将结合 IBM 在企业安全、合规和混合云环境中的经验，以及 OpenAI 在前沿 AI 模型方面的能力。该合作面向企业级网络安全需求，重点服务安全运营、威胁检测和事件响应等场景。

人在草木间

■ IBM（IBM.N）：发布全球首个亚 1 纳米芯片技术

下载日志已记录，仅供内部参考

IBM 宣布推出全球首个 sub-1 nanometer（亚 1 纳米）芯片技术，该技术基于公司新型 NanoStack 半导体架构，目标是在更小晶体管尺度下提升芯片性能与能效。IBM 称，该技术可用于下一代 AI、高性能计算、移动设备和云基础设施等场景。

技术设计方面，NanoStack 采用垂直堆叠纳米片结构，用于在有限芯片面积内提高晶体管密度，并改善功耗表现。IBM 表示，与现有先进制程相比，该方案有望在同等功耗下提升计算性能，或在同等性能下降低能耗，从而支持更高密度的 AI 计算和数据中心工作负载。

IBM 表示，该成果延续了其在 2 纳米、纳米片晶体管和先进封装等方向的研发积累。公司称，亚 1 纳米技术仍处于研发阶段，后续需要与半导体制造生态合作推进工艺成熟、材料验证和量产路径探索。

■ **Supermicro（SMCI.O）：推出 NVIDIA Vera Rubin NVL4 端到端 DCBBS 蓝图**

Supermicro 宣布推出面向 NVIDIA Vera Rubin NVL4 平台的端到端 DCBBS（Data Center Building Block Solutions）蓝图，用于融合 HPC 与 AI 基础设施部署。该方案面向需要原生 FP64 性能的科学计算、工程仿真、AI 训练与推理等工作负载。

方案内容包括服务器、机架级集成、液冷、网络、存储、电源和管理软件等数据中心基础设施组件。Supermicro 表示，该蓝图将基于 NVIDIA Vera Rubin 平台，支持客户以模块化方式建设高密度 AI 和 HPC 集群。

公司称，该方案适用于科研机构、云服务商、大型企业和主权 AI 基础设施等场景，可帮助客户缩短从系统设计到部署的周期。

■ **Broadcom（AVGO.O）/ OpenAI：发布面向 LLM 推理优化的 AI 加速芯片 Jalapeño**

Broadcom 与 OpenAI 宣布推出面向大语言模型优化的 Jalapeño Intelligence Processor，该芯片由双方联合开发，定位于 OpenAI 下一阶段 AI 基础设施中的专用推理处理器。Broadcom 表示，Jalapeño 目前已完成工程样片，并已运行 OpenAI 内部模型相关工作负载。

产品设计方面，Jalapeño 针对 LLM 推理中的矩阵计算、内存访问、互连和模型服务流程进行优化，并配套 Broadcom 的以太网、PCIe 和光互连等基础设施能力。OpenAI 表示，该芯片并非通用 GPU 替代品，而是围绕其模型架构和部署需求定制，用于提升大规模推理系统的效率。

部署方面，双方计划在 2026 年开始将 Jalapeño 用于 OpenAI 数据中心基础设施，并推进后续多代产品路线图。Broadcom 称，该合作覆盖芯片、系统、网络和机架级集成环节，面向 OpenAI 未来更大规模的 AI 计算需求。

（二）卫星通信

■ **AST SpaceMobile（ASTS.O）：BlueBird 11、12、13 计划于 8 月上半月发射**

AST SpaceMobile 宣布，旗下 BlueBird 11、12、13 三颗卫星计划于 2026 年 8 月上半月发射入轨，具体时间仍需视发射条件和监管审批等安排而定。此次发射将延续公司低轨空间蜂窝宽带星座部署，用于面向普通智能手机提供直接连接服务。

公司表示，BlueBird 11、12、13 为下一代 BlueBird 卫星，设计上用于提升覆盖范围、网络容量和数据传输能力。AST SpaceMobile 此前已于 6 月成功发射 BlueBird 8、9、10，此次计划发射的三颗卫星将进一步扩展其在轨星座规模。

后续部署方面，AST SpaceMobile 称，公司仍在推进更多 BlueBird 卫星的生产和发射准备。公司目标是建设面向全球移动网络运营商合作伙伴的空间蜂窝宽带网络，目前已与多家移动运营商建立合作关系，服务范围覆盖全球数十亿移动用户。

下载日志已记录，仅供内部参考

■ **Spire Global（SPIR.N）：10 颗卫星已运抵范登堡太空军基地，准备参与 SpaceX 拼车发射**

Spire Global 宣布，已向美国加州 范登堡太空军基地 交付 10 颗卫星，将搭乘 SpaceX 即将执行的拼车发射任务进入轨道。公司表示，这批卫星覆盖多个客户任务，体现其卫星制造、集成、测试和任务运营能力。

此次交付的卫星包括面向 Spire 自有数据服务的任务，以及为客户提供的空间服务任务。Spire 称，公司可通过 Space Services 模式为客户提供卫星平台、载荷集成、发射协调、地面站接入和在轨运营支持，帮助客户更快部署空间数据和通信相关应用。

Spire 目前运营多用途卫星星座，业务覆盖海事、航空、天气、空间态势感知及射频数据等方向。公司表示，此次 10 颗卫星交付是其持续扩展在轨能力和客户任务服务的一部分，相关卫星将在发射后用于支持数据采集、通信和其他空间应用。

（三）AI 应用

■ **Salesforce（CRM.N）：推出 Agentforce Commerce，扩展 AI 智能体在电商场景的应用**

Salesforce 宣布推出 Agentforce Commerce，将其 AI 智能体能力扩展至电商业务场景，帮助企业在购物、客服、订单管理和营销等环节部署可执行任务的 AI Agent。该产品基于 Salesforce Commerce Cloud 和 Agentforce 平台，面向零售、电商和消费品牌客户。

功能方面，Agentforce Commerce 可支持消费者通过自然语言进行商品搜索、推荐、下单和售后咨询，也可帮助商家处理商品目录、促销活动、订单状态、退换货等运营任务。Salesforce 表示，相关智能体能够结合企业客户数据、商品数据和业务规则，在不同渠道中提供更连贯的购物和服务体验。

Salesforce 同时提到，Agentforce Commerce 将与 Data Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud 等产品结合，支持企业在统一数据基础上管理客户互动。公司称，相关能力将帮助商家把 AI 智能体嵌入电商运营流程，并在购物转化、客户服务和运营效率等环节提供支持。

（四）光通信

■ **Corning（GLW.N）：玻璃基板进程加速，Glass Bridge 光互连组件首次亮相**

康宁推出下一代玻璃基板光互连技术，旨在连接光半导体和光纤，面向新兴的共封光学（CPO）和玻璃芯半导体封装架构。公司于 6 月 24 日在首尔浦项大厦（POSCO Tower Yeoksam）举办的 AI 数据中心光通信与互联技术大会上，首次亮相了 Glass Bridge 光互连组件。Glass Bridge 是一种玻璃光学连接器，直接连接光子集成电路（PIC）和光纤。片上光波导宽度达数百纳米，而光纤芯宽达数微米，导致尺寸不匹配数十倍，而 Glass Bridge 利用玻璃内部形成的波导精确连接两结构。

康宁采用基于晶圆的离子交换波导技术，在玻璃内部创建光学通路。光通过光纤被引导通过玻璃波导，送达光子芯片。该技术使 PIC 前端实现高密度光输入/输出（I/O）接口，同时简化光纤与光子器件之间的对准和组装。它消除了对传统可插拔收发器或长光纤阵列单元（FAU）的需求。初始产品设计支持 30 微米或更大的光子芯片芯间距。康宁表示，其目标是光纤与光子芯片之间的耦合损耗低于 2 分贝（dB）。

康宁目前正与多位合作伙伴共同开发 Glass Bridge。去年，公司宣布与 Global Foundries 合作开发 AI 数据中心的光互联技术。公司还展示了下一代 CPO 架构，结合了玻璃基板与光学互连。

下载日志已记录，仅供内部参考

该设计采用了在玻璃基板上形成的光学波导，配备穿透玻璃通孔（TGV），并连接了翻转芯片安装的光子器件。该技术旨在满足未来对玻璃基板半导体封装的需求。

此外，康宁还展示了其 GlassWorks AI 平台，这是一款面向 AI 数据中心的光通信解决方案。GlassWorks AI 为数据中心内部、机架间及数据中心园区之间提供集成的光连接基础设施。该平台包括光纤、电缆、连接器、FAU 和校准组件。康宁最近扩大了对美国北卡罗来纳州和德克萨斯州以及波兰光通信制造设施的投资。公司还与包括 Meta、Nvidia 和亚马逊在内的超大规模企业签订了数十亿美元的长期供应协议。

■ **NVIDIA（NVDA.O）：Vera Rubin 平台切入科学超算，推动 AI 计算与 HPC 架构融合**

NVIDIA 宣布，基于 Vera Rubin 架构的新一代超算平台将面向科学计算场景提供更高 AI 与高性能计算能力。公司表示，单个 Vera Rubin NVL144 机架可提供约 7 exaflops AI 算力和 5 petaflops FP64 算力，计算能力已接近当前 TOP500 排名前列超算的单机架水平。

应用方向上，Vera Rubin 将主要服务气候建模、计算流体力学、量子化学、能源勘探等复杂科学计算任务。该平台延续 NVIDIA 从 GPU、CPU 到网络互连的系统级布局，配套 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink、Quantum-X InfiniBand、Spectrum-X Ethernet 等组件，反映出科学超算正从传统 HPC 集群向 AI 加速、机架级互连和液冷高密度架构升级。

落地进展方面，德国 LRZ Blue Lion、美国能源部 NERSC Doudna、洛斯阿拉莫斯国家实验室 Mission 与 Vision 系统等均将采用 Vera Rubin 相关平台；Dell、HPE、Supermicro、GIGABYTE 等系统厂商也将推出相关机架级方案。

■ **NVIDIA（NVDA.O）：欧洲将建设 35 台 NVIDIA AI 超级计算机**

NVIDIA 宣布，欧洲将建设 35 台新的 NVIDIA AI 超级计算机，覆盖多个国家和地区，用于支持科研、工业、公共部门及 AI 模型开发等应用。相关系统将服务气候、生命科学、制造、能源、机器人、量子计算等领域，进一步扩展欧洲本土 AI 计算基础设施。

配置方面，上述 AI 超算将采用 NVIDIA GPU、CPU、网络互连和软件平台等技术，部分系统将基于 NVIDIA Grace Blackwell、NVIDIA Blackwell 和相关网络方案建设。NVIDIA 表示，这些系统将帮助研究机构和企业处理大规模 AI 训练、仿真、数字孪生和科学计算任务。

项目参与方包括欧洲多地的超级计算中心、大学、研究机构及产业合作伙伴。NVIDIA 称，相关部署将与欧洲主权 AI、科研计算和产业数字化需求结合，推动 AI 算力资源在区域内进一步扩展。

三、行业数据跟踪

（一）大模型 Tokens 调用量

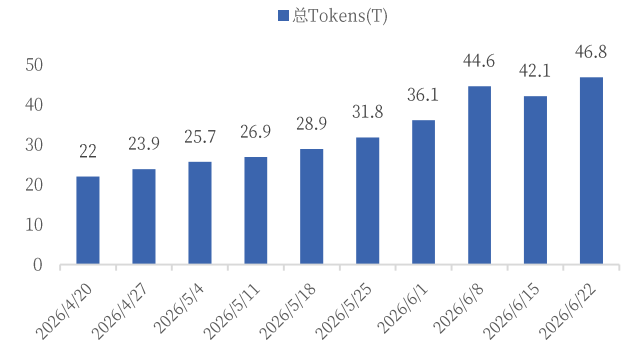
当周模型总调用量为 46.8 万亿 tokens，环比上升 11.16%，较此前一周的 42.1 万亿 tokens 明显回升，并创近十周以来新高。近十周来看，模型调用量整体呈稳步爬升态势，由 2026 年 4 月 20 日的 22.0 万亿 tokens 提升至本周的 46.8 万亿 tokens，累计增幅约 112.73%，显示 AI 模型调用需求仍在持续释放。

分模型厂商来看，本周 Token 市场份额中，Google 占比最高，为 32.50%；OpenAI 位居第二，占比 17.20%；DeepSeek、Qwen、Meta-Llama 分别占比 9.80%、6.50%、6.20%。头部

下载日志已记录，仅供内部参考

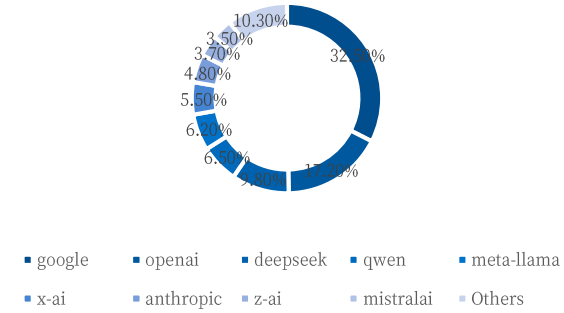
模型厂商份额仍较为集中，Google 与 OpenAI 合计占比接近五成，前五大模型厂商合计占比达 72.20%。

图9：近十周每周总 Token 调用量变化（T）



资料来源：OpenRouter，中国银河证券研究院

图10：本周各模型 Token 市场份额（%）



资料来源：OpenRouter，中国银河证券研究院

分模型来看，本周调用量前五的模型分别为 DeepSeek V4 Flash、MiMo - V2.5、MiniMax M3、Owl Alpha、Hy3 preview，调用量分别为 4.7T、4.54T、3.76T、3.38T、3.29T。其中，Owl Alpha 环比增长 37%，MiMo - V2.5 环比增长 18%，增速表现相对突出；DeepSeek V4 Flash、MiniMax M3、Hy3 preview 环比分别下降 4%、5%、7%，但仍位居本周调用量前列。

表1：本周热门模型 Token 调用量排名

模型	公司	当周 tokens 调用量	环比
DeepSeek V4 Flash	deepseek	4.7T	-4%
MiMo - V2.5	xiaomi	4.54T	18%
MiniMax M3	minimax	3.76T	-5%
Owl Alpha	openrouter	3.38T	37%
Hy3 preview	tencent	3.29T	-7%
Claude Opus 4.7	anthropic	2.36T	-13%
DeepSeek V4 Pro	deepseek	2.05T	-19%
GLM 5.2	z-ai	1.98T	86%
Claude Opus 4.8	anthropic	1.96T	25%
Claude Sonnet 4.6	anthropic	1.49T	-3%

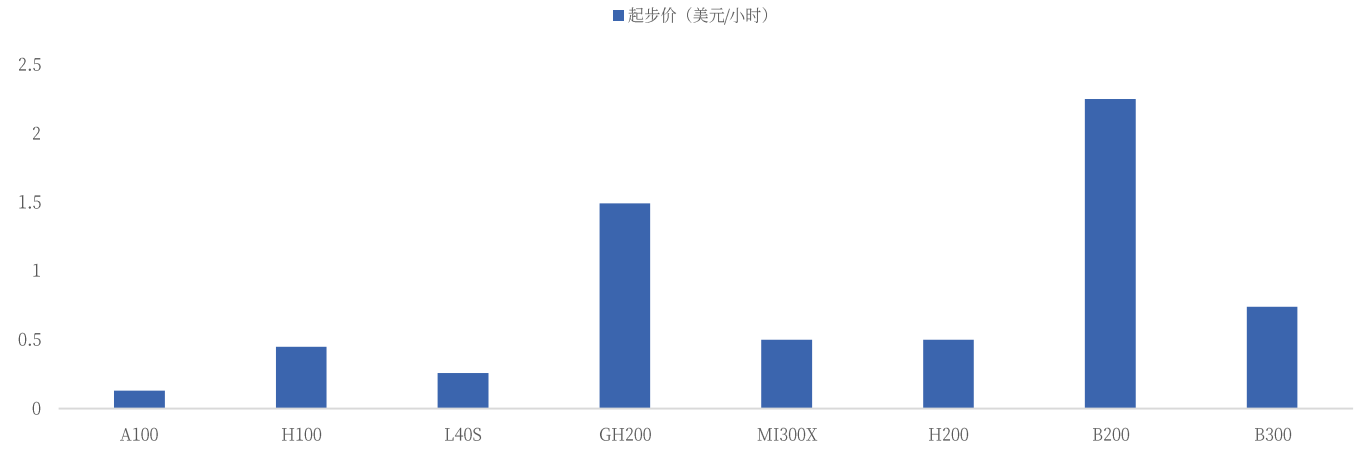
资料来源：OpenRouter，中国银河研究院

（二）热门 GPU 价格走势

根据 Cloud GPU Tracker 数据，最新热门 GPU 起步价情况如下图所示。以 Nvidia A100 为例，最低报价为每小时$0.13 (竞价实例)，配置为 1x A100，80GB 显存，128 vCPU，128GB 内存。

下载日志已记录，仅供内部参考

图11：最新热门 GPU 起步价情况



资料来源：CloudGPUTracker，中国银河证券研究院

（三）子行业技术趋势

表2：子行业技术趋势

行业	技术看点
设备制造	AI 硬件平台继续向机柜级、系统级方案演进，GPU、CPU、NIC、交换机、光互连和液冷的协同设计成为核心方向。NVIDIA NVLink Fusion 支持半定制 AI 基础设施，OpenAI 与 Broadcom 发布面向 LLM 推理的 Jalapeño 定制处理器，强调从设计到生产仅 9 个月、早期测试具备更优性能功耗比，并计划面向 GW 级数据中心部署；Qualcomm 发布 Dragonfly 数据中心路线图，覆盖 AI CPU、HBC 高带宽计算和 AI300 推理加速器；Micron 与 Anthropic 达成 AI 基础设施战略合作，显示内存、存储与模型架构协同的重要性继续上升。
运营商	运营商技术主线从 AI-RAN 性能优化进一步延伸到核心网自动化、网络切片和 B2B 服务编排。Ericsson 将 Intelligent Automation Platform 从 RAN 扩展到核心网，并引入低时延数据流能力，推动 RAN+Core 统一自动化；Telefónica Deutschland 与 Ciena Blue Planet 使用 AI agents 进行 5G 网络切片设计，将复杂服务设计从数周压缩至数分钟，说明 AI 正进入运营商 OSS、MDSO 和企业专网服务交付流程。
光通信	光通信技术主线仍是 AI 数据中心带动 800G 向 1.6T/3.2T 升级，并推动 CPO、硅光、EML 和 VCSEL 等路线并行推进。Ciena 近期强调 AI 网络将由多种光架构共存，客户会根据功耗、光纤资源、频谱效率和部署速度选择不同方案；Coherent 在 OFC 2026 展示 1.6T、3.2T 以及 12.8T 及以上架构，显示光模块升级节奏仍在加快。
卫星通信	卫星通信板块继续围绕 D2D 直连手机和 3GPP NTN 推进。AST SpaceMobile 的 BlueBird 8/9/10 于 6 月 17 日成功发射入轨，进一步补充其低轨直连手机星座。该事件对板块的意义在于，D2D 从技术验证走向卫星规模化部署，后续重点观察在轨卫星数量、商用覆盖区域、运营商合作和监管频谱进展。
行业应用	企业 AI 应用继续从 Copilot 式工具走向生产级 Agent 和流程自动化。AWS Summit New York 发布 AWS Continuum、AWS Context、Amazon Quick autonomous agents、Bedrock AgentCore 增强等能力，核心方向是让 Agent 具备企业数据上下文、可审计动作和持续优化能力；AWS CEO 也表示企业 AI 正在从实验转向 ROI 兑现。应用层周报可继续结合 OpenRouter 模型调用量，观察推理需求和多模型生态活跃度。
算力服务	AIDC 板块的核心变量是 GPU 可得性、MW 容量、长约客户和交付速度。Equinix 与 Cisco、NVIDIA 合作推进 Secure AI Factory，Applied Digital 签署 210MW AI 数据中心租赁，均说明 AIDC 从普通机房托管升级为面向训练和推理的高密度 AI 基础设施。价格侧可以每周跟踪 CloudGPUTracker 和 GPU Lease Index：前者覆盖 47+云 GPU 平台并每小时更新，后者给出 H100 等 GPU 的周度租赁价格区间。
液冷	液冷板块受益于高功耗 GPU 和高密度 AI 机柜持续渗透。Supermicro 发布基于 NVIDIA Vera Rubin NVL4 的端到端 DCBBS 蓝图，单个 3.2MW Scalable Unit 包含最高 1,152 颗 Rubin GPU 和 576 颗 Vera CPU，DLC-2 直液冷支持最高

下载日志已记录，仅供内部参考

	362kW/机柜，并配套 in-row CDU、冷板、歧管和高阻抗冷却液。说明液冷正从配套散热方案升级为 AI/HPC 整机柜交付能力的一部分。

资料来源：中国银河研究院整理

四、投资建议

康宁推出下一代玻璃基板光互连技术，旨在连接光半导体和光纤，面向新兴的共封光学（CPO）和玻璃芯半导体封装架构。公司于 6 月 24 日在首尔浦项大厦（POSCO Tower Yeoksam）举办的 AI 数据中心光通信与互联技术大会上，首次亮相了 Glass Bridge 光互连组件。

我们认为，此次 Glass Bridge 的发布是光进铜退进程中的重要节点，其产业意义可从三个层面理解。1）技术层面，CPO（共封光学）规模化落地的核心瓶颈之一，正是光子芯片与光纤间因模场尺寸差异（数百纳米 vs.数微米）带来的高耦合损耗与精密对准难题，传统 FAU 方案通道间距大、密度受限且封装后难维护；Glass Bridge 借助玻璃内部离子交换波导做模场过渡，支持 30μm 级高密度通道（较 127μm FAU 密度提升约 4 倍）、耦合损耗<2dB 且可实现 TMT 插芯可拆卸被动对准，实质上把 CPO 从实验室可通光推向机房可运维。**2）材料层面，**玻璃基板凭借透光性（适配光波导）、热膨胀系数与硅匹配、TGV（玻璃通孔）成本优于硅 TSV 等特性，正在从显示/盖板传统领地切入高端半导体封装与光互连核心环节，与有机基板（高频损耗大）、硅中介层（不透光、贵）形成差异化卡位，康宁将显示玻璃/玻纤积累平移至 AI 基建，是材料端护城河被重估的典型样本。**3）产业趋势层面，**AI Factory 的瓶颈正从单卡算力向外溢至机架内/集群间光互连的带宽、功耗与密度，可插拔光模块→LPO→CPO 的技术代际切换已开启，玻璃基光波导、TGV 工艺、可拆卸光连接、CPO 封装等环节的价值量占比将持续抬升；康宁同期推出 GlassWorks AI 全栈平台（芯片/板/机架/园区级）及玻璃基 CPO 基板方案，并与格芯联合验证、在美/波扩产、拿下 Meta/NVIDIA/亚马逊数十亿美元级长协，表明头部云厂与算力玩家已在供给侧锁定玻璃基光互连产能。对产业链而言，Glass Bridge 的产业化提速将进一步把订单与估值弹性向玻璃基板材料、TGV 加工、IOX/硅光波导、CPO 封装与可拆卸光连接等细分环节扩散。建议关注相关龙头标的：

光模块/光通信相关标的：Lumentum（LITE），Coherent（COHR），Fabrinet（FN），Corning Inc.（GLW），Applied Optoelectronics（AAOI）等；设备制造相关标的：Ciena（CIEN），Cisco Systems（CSCO），Micron Technology（MU）等；运营商相关标的：AT&T（T），Verizon（VZ），T-Mobile US（TMUS）等；行业相关标的：Oracle（ORCL），Nvidia（NVDA）等。

五、风险提示

1、 AIGC 应用推广不及预期的风险；

2、 下游 CSP 厂商 Capex 不及预期的风险；

3、 政策和技术摩擦的不确定性风险；

4、 5G 规模化商用推进不及预期的风险等。

下载日志已记录，仅供内部参考

图表目录

图 1： 各主要指数一周涨跌幅对比 3
图 2： 各主要指数年初至今涨跌幅对比 3
图 3： 各主要指数一周成交额对比 3
图 4： 各主要指数年初至今成交额对比（亿美元） 3
图 5： Nasdaq-100 中周涨幅前十名标的汇总（%） 4
图 6： Nasdaq-100 中周跌幅前十名标的汇总（%） 4
图 7： 一周细分子板块涨跌幅情况（%） 4
图 8： 年初至今子板块涨跌幅（%） 4
图 9： 近十周每周总 Token 调用量变化（T） 9
图 10： 本周各模型 Token 市场份额（%） 9
图 11： 最新热门 GPU 起步价情况 10

下载日志已记录，仅供内部参考

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

赵良毕，通信&中小盘首席分析师，科技组组长。北京邮电大学通信硕士，复合学科背景，2022 年加入中国银河证券。8 年中国移动通信产业研究经验，7 年证券从业经验。曾获得 2018/2019 年（机构投资者 II-财新）通信行业最佳分析师前三名，2020 年获得 Wind（万得）金牌通信分析师前五名，获得 2022 年 Choice（东方财富网）通信行业最佳分析师前三名。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：	相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～10%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：	相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%～20%之间
		中性：	相对基准指数涨幅在-5%～5%之间
		回避：	相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn
程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：林 程 021-60387901 lincheng_yj@chinastock.com.cn
李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn
褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn